

**Applied Materials Introduces New Technologies and Solutions to Accelerate the Semiconductor Industry Roadmap for Heterogeneous Integration – September 9, 2021**



アプライド マテリアルズのAdvanced Packaging Development Centerにおいてダイ・トゥ・ウェーハハイブリッドボンディングに向けた新たな先進的ソフトウェアモデリングとシミュレーションを活用し、お客様の製品投入を迅速化

EV Groupとの間でウェーハ・トゥ・ウェーハハイブリッドボンディングソリューションに関する共同開発契約を締結

先日のTango Systems（パネルレベルのプロセスをリードする企業）買収により、先進的パッケージング向けに大型で高品質の基板の提供が可能に

ディスプレイ事業で培った大型パネルサイズ基板の歩留まり管理ソリューションなどのテクノロジー活用をお客様に提供

アプライド マテリアルズ（Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社：米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼CEOゲイリー・E・ディッカーソン）は9月8日（現地時間）、ヘテロジニアスなチップデザインとインテグレーションに向けたお客様の技術ロードマップを加速する新たなテクノロジーとソリューションを投入しました。

アプライド マテリアルズは先進的パッケージング技術と大型パネルサイズ基板技術でのリーダーシップを業界コラボレーションと組み合わせ、PPACT™（消費電力、性能、面積あたりコスト、市場投入までの期間）を同時に改善するソリューションの提供を加速しています。

[https://www.excite.co.jp/news/article/Ptimes\\_2021-09-10-53218-35/](https://www.excite.co.jp/news/article/Ptimes_2021-09-10-53218-35/)